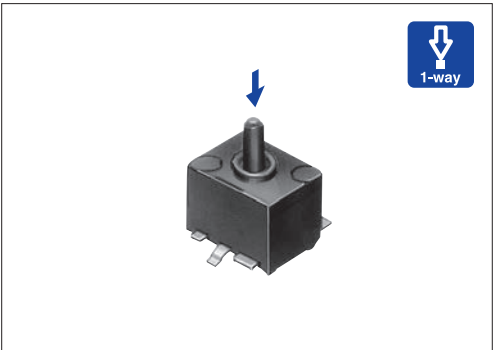


最适合媒体感知的单向型。



主要规格



项目		规格
最大额定/最小额定 (电阻负载)		0.1A 30V DC / 100 μ A 3V DC
接触电阻 (初期/寿命后)		1 Ω max. / 2 Ω max.
动作力		0.3N max.
操作寿命	无负载	100,000 cycles
	负载	100,000 cycles (0.1A 30V DC)

产品一览

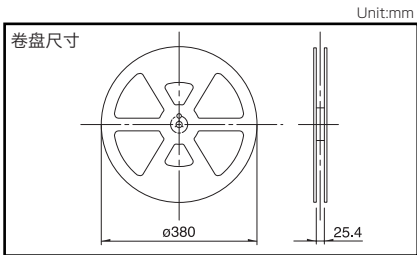
回路数	接点数	端子形状	滑动杆高度 (mm)	ON 位置 (mm)	全行程位置 (mm)	最小订货单位 (pcs.)		产品编号	图号	
						日本	出口			
1	1	For PC board (Reflow)	h = 6.1	h ₁ = 5.6	h ₂ = 4.45	1,000	4,000	SPPW812302	1	
		For PC board (Dip)				100	20,000	SPPW812300	2	
		For PC board (Reflow)	h = 6.55	h ₁ = 6.05	h ₂ = 4.85	1,000	4,000	SPPW810201	1	
		For PC board (Dip)				100	20,000	SPPW810203	2	
		For PC board (Reflow)	h = 7.6	h ₁ = 7.1	h ₂ = 5.9	850	3,400	SPPW811203	1	
		For PC board (Dip)				100	20,000	SPPW811200	2	
		For PC board (Reflow)	10.3	9.8	8.6			SPPW810401	3	
		For PC board (Dip)						SPPW810400	4	

注

关于其他滑动杆高度，请另行商议。

包装规格
载带

产品编号	包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
	卷盘	1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装		
SPPW812302 SPPW810201	1,000	2,000	4,000	24	406×406×160
SPPW811203	850	1,700	3,400		



散装

产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装	
SPPW812300, SPPW810203, SPPW811200, SPPW810401, SPPW810400	4,000	20,000	400×270×290

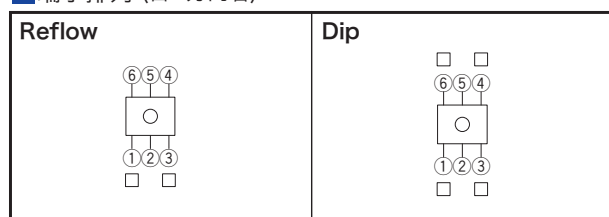
■外形图

Unit:mm

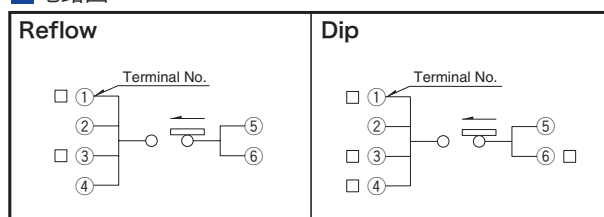
No.	形状	印刷电路板安装孔尺寸图 (自A方向看)
1	Reflow 	
2	Dip 	
3	Reflow 	
4	Dip 	

- 注** 1. 外形图表示的是有定位销的产品类型。
2. 还有无定位销型。

■端子排列 (自A方向看)



■ 电路图



- 注** 1. □记号为切断端子。
2. 关于上述以外的端子形状, 请另行商议。

检测开关

产品系列一览

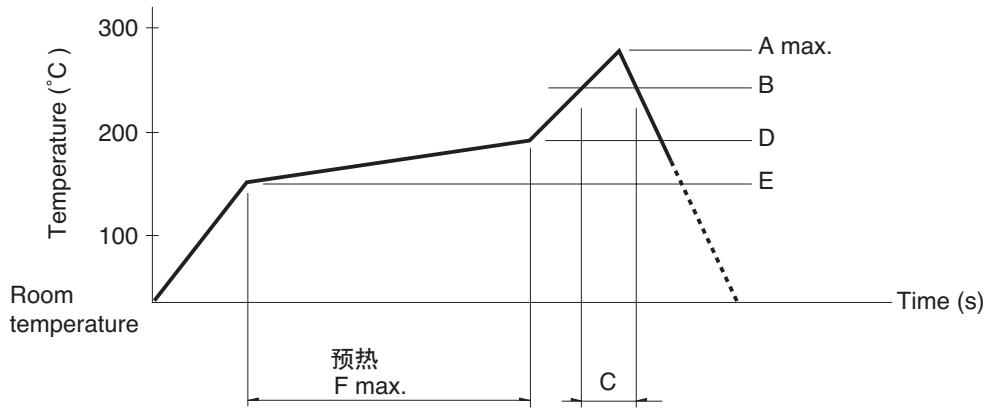
防水型

检测开关焊接条件	71
使用检测开关时的注意事项	72

表中的 ● 符号表示适用于系列内的全部产品。

回流方式的参考举例

- 1. 加热方式远红外线加热的上下加热方式。
- 2. 温度测量方式用φ0.1～φ0.2的CA (K) 或CC (T) 进行测量。在焊接的连接部位置 (铜箔面) 测量, 固定方式使用耐热载带。
- 3. 温度分布



系列 (回流型)	A (°C) 3s max.	B (°C)	C (s)	D (°C)	E (°C)	F (s)
SPPB	250	230	40	180	150	120
SPPW8			35			
SPVE	260		40			
SPVL						
SPVM						
SPVN						
SPVR						
SPVS						
SPVT						
SSCM						
SSCQ						
SPVQC						

注

- 1. 上述条件, 为印刷电路板的零部件表面的温度。根据电路板的材质, 大小, 厚度等, 电路板温度和开关表面温度会有很大的不同, 关于开关表面温度, 也请在上述条件内使用。
- 2. 根据贴面焊槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

手工焊接方式的参考举例

项 目	焊接温度	焊接时间
SPVS, SPVN, SSPVT, SPVM, SPVR, SPVE, SPPW8, SSCQ, SSCM, SPVL, SSCT, SPVQC	350±5°C	3s max.
SPVQ1, SPVQ3, SPVQ6, SPVQ7, SPVQ8, SPVQ9, SSCN, SPVQA	300±10°C	3+1/0s
SPPB (Reflow)	350±5°C	5s max.
SSCF, SPPB (For Lead, Dip)	350±10°C	3+1/0s

浸焊方式的参考举例

适用于 For PC board 端子型

项 目	项目		浸焊	
	预热温度	预热温度时间	焊接温度	焊接浸渍时间
SSCT, SPVQ1, SPVQ3, SPVQ6, SPVQ7, SPVQ8, SPVQ9, SPVQA	100±10°C	60s max.	260±5°C	5±1s
SPPW8, SPPB	100 °C max.	60s max.	255±5°C	5±1s
SSCF	—		260±5°C	5±1s